

Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Ihr Ansprechpartner

Falk Lange

Durchwahl

Telefon +49 351 564 60200

falk.lange@smwk.sachsen.de*

10.12.2013

Fraunhofer bündelt Kompetenzen am Standort Dresden

Der Freistaat Sachsen ist einer der bundesweit stärksten Standorte der Fraunhofer-Gesellschaft. Um die Präsenz hier nachhaltig zu stärken, hat der Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft beschlossen, Schlüsselkompetenzen in Dresden zu bündeln.

Eine Veränderung erfolgt am Dresdner Teil des Fraunhofer-Instituts für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP. Zum 1.1.2014 werden die derzeit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS integriert - unter Leitung von Prof. Alexander Michaelis. Ziel ist es, die komplementären Kompetenzen in eine gemeinsame Wertschöpfungskette einzubinden und durch den Schwerpunkt Materialdiagnostik auszubauen. Damit stärkt Fraunhofer in Dresden seine Position als führende Institution für die Entwicklung von Struktur- und Funktionskeramiken.

Eine andere Entscheidung betrifft die Fraunhofer-Einrichtung für Organik, Materialien und Elektronische Bauelemente COMEDD mit ihren 75 Mitarbeitenden. Sie soll mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP zusammengeschlossen werden. Der Leiter des Fraunhofer FEP Professor Volker Kirchhoff wird zum 1.1.2014 auch die kommissarische Leitung des COMEDD übernehmen.

„Mit diesem Schritt wollen wir den Fraunhofer Standort Dresden im Bereich der Oberflächenbeschichtung und Entwicklung von flexiblen Bauelementen weiter voranbringen und so auch auf geänderte Marktentwicklungen bei der organischen Elektronik reagieren“, sagt Professor Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. „Gerade wir bei Fraunhofer sind gefordert mit unseren Entwicklungen und Innovationen der Dynamik der Märkte zu begegnen. Dazu gehört auch, die entsprechenden Forschungsstrategien den Erfordernissen anzupassen.“

Auch der Freistaat Sachsen unterstützt die Entwicklungen für den Standort. Staatsministerin Sabine von Schorlemer: „Unsere Einrichtungen

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

im Freistaat Sachsen sind führend auf dem Gebiet der organischen Elektronik. Diese wichtigen und zukunftsfähigen Forschungspotenziale werden bei Fraunhofer in Dresden fortgeführt. Das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl und Plasmatechnik FEP und die Fraunhofer-Einrichtung für Organik, Materialien und Elektronische Bauelemente COMEDD nutzen bereits seit längerem gemeinsam Forschungsinfrastruktur und arbeiten eng bei Forschungsprojekten zusammen, etwa wenn es um Technologien geht, wie flexible OLEDs auf Folien aufgebracht werden können. Fraunhofer wird auch in Zukunft wichtiger Partner der Wirtschaft sein und vielfältige Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotfertigungsmöglichkeiten, insbesondere für OLED-Beleuchtung, organische Solarzellen, OLED-Mikrodisplays und Sensoren bieten können.“

Es zeichnet sich ab, dass künftig verstärkt flexible Anwendungen zur Integration in unterschiedlichste Untergründe und Systeme gefordert sind, etwa OLED, die auf flexible Substrate wie Folien aufgebracht werden. An dieser Stelle ergeben sich durch den Zusammenschluss des Fraunhofer FEP und COMEDD in Dresden neue Potenziale für die Oberflächenbeschichtung, die Verkapselung der OLED-Folien und flexiblen Substrate aber auch bei OLED, die auf Siliziumwafern produziert werden. Dadurch lassen sich die Entwicklungen in diesen Bereichen voranbringen. Zudem ergibt sich ein interessantes Potenzial für europäische Unternehmen zum Beispiel im Automobilbau, wo OLED als Rückleuchten oder zur Innenraumbeleuchtung direkt in gebogene Flächen integriert werden können. „Wir wollen den wachsenden Anforderungen zeitnah gerecht werden und verknüpfen deshalb konsequent unsere in Dresden vorhandenen Kompetenzen aus der Beschichtungstechnologie für die organische Elektronik der Zukunft“, erklärt Professor Neugebauer. Im nächsten Schritt befassen sich die Fraunhofer-Gremien mit der Integration, die zum 1. Juli 2014 vollzogen werden soll.

Das integrierte COMEDD und die weiteren Bereiche des FEP sollen mit Unterstützung des Landes eng mit der Technischen Universität Dresden kooperieren.